

## INVITATION

2014第 23 屆虎門科技 CAE 應用年會邀請函

2014年11月11日世貿南港展覽館

尊敬的業界先進：

跨領域 CAE 技術交流大會“虎門科技 CAE 應用年會”再次來臨。11月 11日，“2014第 23 屆虎門科技 CAE 應用年會”將在世貿南港展覽館隆重再度舉辦，我們真誠邀請您出席此次最具震撼力的 CAE 年度盛會！

虎門科技股份有限公司(CADMEN)自 1992 年來，主辦全國最大的 CAE 用戶交流大會，為我國工業界不斷創造研發能量。國內正面臨有史以來最強烈國際競爭壓力背景下為提升產業研發力應運而生的 CAE 大盛事。伴隨著全球製造業的不斷創新升級，臺灣 CAE 市場也日漸成熟，此次技術大會，不但匯集 CAE 領域最先進的趨勢與主題，更將凝聚 ANSYS 及各領域最前衛的 CAE 資訊與技術，與國內 CAE 專家共同探討，如何利用系統工程設計(SYSTEM DESIGN)實現更快地創新，開發新一代產品等重要科技趨勢，開創系統級工程模擬創新之路。

在這裡，您能見到：國內頂尖模擬技術專家與學者；數百位 ANSYS 及其他 CAE 技術專家；國內知名模擬技術應用成功企業案例。

在這裡，您能聽到：全球知名 CAE 專家解析不同產業發展趨勢；企業應用 CAE 技術案例分享；全新的技術解決方案。

在此，作為臺灣 CAE 的重要推手，虎門科技誠邀您出席“2014第 23 屆虎門科技 CAE 應用年會”，與我們一起分享中外專家在工程模擬技術領域實踐中的挑戰、經驗與成果，以及駕馭新技術的心得與洞察。讓我們在面對面的交流中，一起追尋模擬科技的發展軌跡，感受“跨領域”的力量！

期待您的撥冗蒞臨！

2014 虎門科技 CAE 應用年會-會務組

2014 年 10 月

### 基本資訊

- **會議時間**：2014年11月11日
- **會議地點**：世貿南港展覽館 4F・5F 會議廳
- **展館地址**：115 台北市南港區經貿二路 1 號

【台北捷運藍線(板南線)南港展覽館站】

AM 08:30 - PM 05:30 上午全體會議議程 (401 廳)

時間

議題

單位

講者

|             |  |                          |                 |
|-------------|--|--------------------------|-----------------|
| 08:30~09:00 | 報到                                       |                          |                 |
| 09:00~09:10 | 致開幕詞歡迎詞                                  |                          |                 |
| 09:10~09:30 | 大會主席專題講座                                 | 工業技術研究院中分院<br>智慧化工具機技術中心 | 羅佐良 博士/副主任      |
| 09:30~09:50 | CAE 應用極大化                                | 虎門科技                     | 楊舜如<br>總裁       |
| 09:50~10:20 | CADMEN 2014/2015 回顧與展望                   | 虎門科技<br>CAE 事業部          | 廖偉志<br>副總經理     |
| 10:20~10:30 | 休息                                       |                          |                 |
| 10:30~11:00 | 建構系統設計的方法                                | 工業技術研究院<br>機械所電動車組       | 江文書 博士/組長       |
| 11:00~11:30 | ANSYS 多重物理整合展示                           | 虎門科技 CAE 事業部             | 技術團隊            |
| 11:30~12:00 | LS-DYNAR Recent Developments and Roadmap | 美國 LSTC 公司               | 蔡振世<br>博士/國際總經理 |
| 12:00~13:30 | 午餐                                       |                          |                 |
| 13:30~15:00 | 主題分廳會議【一】 (每個主題 30 分鐘)                   |                          |                 |
| 15:00~15:30 | Tea break                                |                          |                 |
| 15:30~17:00 | 主題分廳會議【二】 (每個主題 30 分鐘)                   |                          |                 |
| 17:00~17:30 | 幸運抽獎&推選 2015 新任虎門 CAE 應用年會會長             |                          |                 |

#### 下午分廳會議議程

##### ■ 熱管理/3C 散熱

| 議題  | 單位                  | 講者        |
|---|---------------------|-----------|
| 封裝設計之多物理耦合分析  | 虎門科技<br>CAE 事業部     | 黃紀源 技術經理  |
| Smartphone thermal management                                 | 工業技術研究院<br>電子與光學研究所 | 劉君愷 博士    |
| Multiphysics Optimization of an LED Light Bulb<br>Using ANSYS | 虎門科技<br>CAE 事業部     | 李虹棋 技術工程師 |
| 散熱設計最佳化   | 啓基科技股份有限公司          | 劉湘肇 副理    |
| ANSYS CFD v16 新版發表  | 虎門科技                | 黃宋儒 技術工程師 |

|                         |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
|                         | CAE 事業部         |          |
| ANSYS ICEPAK v16 新版功能介紹 | 虎門科技<br>CAE 事業部 | 黃紀源 技術經理 |

#### ■ 半導體/微機電產業

| 議題   | 單位                                   | 講者             |
|--|--------------------------------------|----------------|
| ANSYS 應用於 3D 記憶體之模擬分析  | 旺宏電子                                 | 楊文呈 博士         |
| Modal analysis for MEMS switch considering the pre-stress effect caused by electrostatic force | 立錡科技                                 | 王寧遠 工程師        |
| What does ANSYS bring to Tong Hsing on Ceramic Substrate and Electronic Package                | 同欣電子                                 | 鄭武輝 工程師        |
| 封裝 LeadFrame 與 Substrate 架構設計與散熱分析比較   | 菱生精密                                 | 林子智 工程師        |
| An Efficient Evaluation Method for Packaging Interconnection                                   | 台達電子<br>Advanced Process & Packaging | 李嘉炎 博士         |
| Wavefront 於電漿分析應用  | Wavefront                            | Mr. Shibata 社長 |

#### ■ 精密機械/工具機

| 議題                   | 單位                       | 講者         |
|----------------------|--------------------------|------------|
| 工具機主軸動剛性驗證與切削性能整合技術  | 工業技術研究院中分院<br>智能化機器技術部   | 陳佩吟 工程師    |
| 工具機結構動態特性與切削性能整合分析技術 | 工業技術研究院中分院<br>智能化機器技術部   | 廖建智 工程師    |
| ANSYS 結構拓樸優化外掛模組與應用  | 工業技術研究院中分院<br>智能化機器技術部   | 王嘉霈 工程師    |
| 工具機數位設計技術            | 工業技術研究院中分院<br>智慧化工具機技術中心 | 羅佐良 博士/副主任 |
| 渦流夾爪最佳化設計            | 工業技術研究院機械所<br>嵌入式控制系統部   | 楊政城 研究員    |

#### ■ 流體分析應用

| 議題 | 單位 | 講者 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| Unsteady Simulation of Burning Off Carbon<br>Deposition in a Coke Oven | 空軍航空技術學院<br>飛機工程系 | 徐子圭 教授     |
| 以 ANSYS DM, CFD, Mechanical 及 SmartDO 建立風<br>扇葉片自動最佳化設計系統              | 崑崙科技              | 陳申岳 博士/總經理 |
| 煙囪效應在 LED 汽車頭燈散熱模組之設計運用  | 國立台灣科技大學<br>機械工程系 | 林顯群 教授     |
| ANSYS FLUENT 應用於風機的流場與噪音設計分析   | 核能研究所             | 鄭景木 工程師    |
| 鍍鋅產線氣刀分析技術開發與應用  | 中鋼公司<br>新材料研究發展處  | 鄒穎 工程師     |
| 轉爐洗塵水系統地下室環境溫度改善方案   | 中鋼公司              | 張至中 工程師    |